



Veröffentlicht auf *edacentrum* (<https://www.edacentrum.de>)

[Startseite](#) > Druckeroptimiertes PDF

edaWorkshop16 - Call for Papers

Einreichung von Beiträgen

Herunterladen des Call for Papers [hier](#) [1].

Die Deadline zur Einreichung von Beiträgen ist der 3. Februar 2016.

Zur Einreichung nutzen Sie bitte unser Online-Formular, das [hier](#) [2] verfügbar ist.

Neben der Darstellung von EDA-Forschungsvorhaben und ihrer Ergebnisse zielt der edaWorkshop auf die Präsentation industrierelevanter Forschungs- und Entwicklungsergebnisse aus dem unten genannten Themenspektrum.

Erwartet werden Beiträge zu einer der sechs nachfolgend aufgeführten Kategorien:

1. Wissenschaftliche Beiträge aus Forschungseinrichtungen und Industrie, die neue Ergebnisse der EDA-Forschung und -Entwicklung vorstellen
2. Vorträge mit Visions- oder Überblickscharakter zu wissenschaftlichen und praxisrelevanten Themenbereichen
3. Beiträge zur Anwendungsrelevanz und wirtschaftlichen Bedeutung technischer Problemstellungen oder -lösungen
4. Erfahrungsberichte und Berichte zur Ergebnisverwertung in der industriellen Praxis
5. Demonstrator-Beiträge von F&E-Ergebnissen, insbesondere von solchen aus „IKT 2020“-EDA-Projekten
6. Vorträge oder Sessions über Forschungsprojekte zu Anwendungen der Mikroelektronik.

Dabei sind solche Einreichungen besonders willkommen, wenn sie den Bedarf adressieren, Anwendungsaspekte bereits im Entwurfsprozess zu berücksichtigen. Solche Beiträge sind insbesondere interessant für den edaWorkshop, wenn sie Brücken für den Entwurf entlang der Wertschöpfungskette zwischen Anwendungen und Chip-Design bauen.

Das Programmkomitee mit führenden EDA-Experten aus Industrie und Forschung wird die eingereichten Beiträge kategorie-spezifisch begutachten und daraus ein Programm bestehend aus Vorträgen, Postern und Demonstratoren zusammenstellen. Die auf diese Weise ermittelten Beiträge werden in einem Tagungsband veröffentlicht. Der Tagungsband wird mit ISBN-Nummer erscheinen. Poster-, Vortrags- und Demonstrator-Beiträge werden gleichberechtigt in den Tagungsband aufgenommen. Die Tagungssprache ist Deutsch.

Termine

Die Deadline zur Einreichung von Beiträgen: 3. Februar 2016

Zur Einreichung klicken Sie bitte [hier](#) [2].

26. Februar 2016: Benachrichtigung über die Annahme

18. April 2016: Abgabe der druckfertigen Beiträge

11. – 12. Mai 2016: edaWorkshop in Hannover

Modalitäten

Bitte reichen Sie Ihren Beitrag (in deutscher oder englischer Sprache) auf 4-6 Seiten (Kategorie 6 nur 1-2 Seiten) ab Januar 2016 unter www.edacentrum.de/daworkshop/upload [2] als anonymisierte PDF-Datei ein.

Hinweise für Autoren und die zu verwendenden Vorlagen für Ihren Beitrag (Word und LaTeX) finden Sie hier:

- [Templates und Guidelines für LaTeX](#) [3] (in Deutsch und Englisch)
- [Templates und Guidelines für Word](#) [4] (in Deutsch und Englisch)

Der Call for Papers als pdf zum Herunterladen ist [hier](#) [1] zu finden. Die Tagungssprache ist Deutsch. Die Dauer der Vorträge wird ungefähr 20 Minuten betragen.

Themen für den edaWorkshop16

Beiträge zu den folgenden Themen sind willkommen:

Themenspektrum zum edaWorkshop

Unter anderem sind Einreichungen zu folgenden Themen willkommen:

- System-Level- und Hardware-Software-Design für eingebettete Systeme**
 - Spezifikation und Modell-basierter Entwurf
 - Architektur-Synthese und Optimierung
 - Fortschrittliche Architekturen (ASIPs, SoCs, MPSoCs, NoC, SiPs und rekonfigurierbare Architekturen)
 - Transaction-Level-Modellierung und Simulation
 - Entwicklung und Optimierung Hardware-naher Software
- Design und Verifikation**
 - Formale Verifikation
 - Statistische Timing-Analyse und Variabilität
 - Low-Power-Design, -Analyse und -Optimierung
 - Logik- und technologieabhängige Synthese für Nano-Schaltungen
 - Physikalischer Entwurf und Verifikation
 - Simulationsbeschleunigung und Rapid-Prototyping
 - Produktivität und Effizienz des Entwurfs
- Analog- und Mixed-Signal Entwurf**
 - Entwurfsautomatisierung für Analogschaltungen
 - Synthese, Simulation und Verifikation
 - HF- und Smart-Power-Schaltungen
 - Modellgenerierung
 - Parasitäre Effekte und Interconnects
 - Signal-Integrität und EMV
- More than Moore**
 - 3D-Entwurf, Packaging und SiP
 - Entwurf zur Integration von Multi-Domain-Komponenten
 - Energieeffizienter Entwurf
 - Analyse und Optimierung von Performanz und Energieeffizienz
 - Cyber-Physikalische Systeme
 - Design für neue Technologien
 - Design für spezielle Anwendungen
- Zuverlässigkeit, Robustheit und Test**
 - Design für Zuverlässigkeit und Robustheit
 - Modellierung von Alterungseffekten
 - Designzentrierung und Ausbeuteoptimierung (DIM)
 - Fehlertoleranter und selbstheilender Systementwurf
 - System- und Produktionstest
 - Delay-Test und Defekt-orientierter Test
 - BIST und Design for Testability
 - Testgenerierung, Diagnose und Fehlermodellierung
 - Test regulärer Strukturen

Programmkomitee edaWorkshop

Tagungsleitung & Programmkomitee

Tagungsleitung

- W. Rosenstiel, U Tübingen, edacentrum
- W. Nebel, OFFIS, edacentrum

Programmkomitee

Vorsitz:

- O. Bringmann, U Tübingen
- U. Schlichtmann, TU München

- W. Anheier, U Bremen
- M. Dietrich, Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen
- W. Ecker, Infineon Technologies AG
- K. Hahn, U Siegen
- S. Kern, Atmel Automotive GmbH
- W. Kunz, TU Kaiserslautern
- R. Pferdenges, Infineon Technologies AG
- M. Schächtele, Robert Bosch GmbH
- R. Sommer, IMMS gGmbH
- P. van Staa, Robert Bosch GmbH
- J. Doblaski, X-FAB
- R. Ernst, TU Braunschweig
- L. Hedrich, U Frankfurt
- A. Klotz, Cadence Design Systems GmbH
- V. Meyer zu Bexten, Infineon Technologies AG
- M. Reuter, Mentor Graphics (Deutschland) GmbH
- K. Schneider, TU Kaiserslautern
- G. Teepe, GLOBALFOUNDRIES Dresden
- N. Wehn, TU Kaiserslautern
- W. Daehn, Fachhochschule Magdeburg-Stendal
- R. Drechsler, U Bremen
- W. Glauert, U Erlangen-Nürnberg
- H. Gräß, TU München
- A. Herkersdorf, TU München
- J. Kamppe, FH Jena
- G. Kommann, Intel Deutschland GmbH
- A. Hoffmann, Synopsys GmbH
- M. Reuter, Mentor Graphics (Deutschland) GmbH
- S. Sattler, U Erlangen-Nürnberg
- H. Schmidt-Habich, Infineon Technologies AG
- J. Teich, U Erlangen-Nürnberg
- H.-J. Wunderlich, U Stuttgart
- J. Haase, edacentrum
- R. Popp, edacentrum
- D. Treytnar, edacentrum
- P. Federer, GI
- V. Schanz, ITG im VDE
- R. Schnabel, VDE/VDI-GMM

Organisationskomitee

Kontakt

Ralf Popp
edacentrum
Schneiderberg 32
30167 Hannover
fon +49 511 762-19697
fax +49 511 762-19695
E-Mail: edaworkshop@edacentrum.de

edacentrum | Schneiderberg 32 | 30167 Hannover | fon: +49 511 762-19699 | fax: +49 511 762-19695 | emailinfo@edacentrum.de

Quell-URL: <https://www.edacentrum.de/veranstaltungen/edaworkshop/2016/call>

Links:

- [1] <https://www.edacentrum.de/system/files/files/edaWS16-call.pdf>
- [2] <https://www.edacentrum.de/edaworkshop/upload>
- [3] https://www.edacentrum.de/system/files/files/edaWS16-vorlage_tex.zip
- [4] https://www.edacentrum.de/system/files/files/edaWS16-vorlage_word.zip